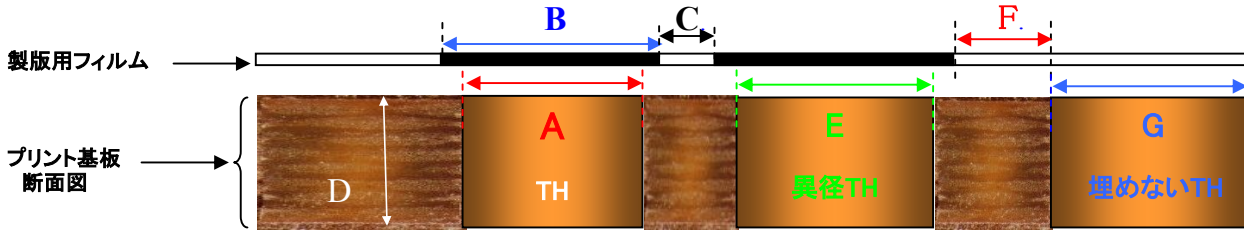


フラットプラグ加工仕様

(株)野田スクリーン

登録日 2014年02月06日



1)加工基本仕様 (下記から1点でも外れるものはツール手配前に事前打合せ要)		
項目	加工仕様	注記
①ワークサイズ	□ 255 ~ 515×615 mm	範囲外は事前検討が必要
②板厚(D)	0.12 ≤ D ≤ 6.50 mm	基材厚の最薄は0.10mmまで
③THキリ径(A)	0.10 ≤ A ≤ 0.80 mm	0.40mm < A はインクの制約あり 0.60mm ≤ A は真空印刷を検討
④アスペクト比(D ÷ A)	40以下	インクやTHメッキ厚によっては例外あり
⑤TH異径(E-A) 差	0.20mm未満 ※	異径差0.20mm以上は分割印刷を検討
⑥フィルムドット接近最小距離(C)	0.10mm以上 ※	0.10mm未満は真空印刷を検討
真空印刷仕様(②③④⑥注意)	板厚3.0mm以上、アスペクト比10以上 基板端面から10mm以上離れること	インクやTHメッキ厚によっては例外あり
⑦TH加工エリア	基板端面から10mm以上離れること	充填するTH対象
⑧TH密集部	THの密集部 片辺20mm以内	ピッチ(C)が0.10mm未満が対象
⑨穴埋め印刷固定用ガイド穴	2.00 ≤ ガイド穴 ≤ 3.50mm	弊社在庫にあるガイドピッチ
⑩ハーフエッチング	15 μm ≤ 仕上がり導体厚狙い値	基礎銅箔エッチング品は除く 最小エッチング量 4 μm

※UV硬化インク(DC5-4)の場合、異径差0.10mm未満、フィルムドット接近最小距離0.15mm以上であること。

2)加工に際してその他注意事項		
項目	注意事項	注記
①表面導体厚切削量	約 3~5 μm	標準インクの加工フローでの参考値
②充填しないTH径(G) 1	1.00mm以下	パフカス詰まり発生リスク有り
③充填しないTH径(G) 2	2.00mm以上	エッジ切れリスク有り
④充填しないTHと充填するTH製版用フィルムエッジ間距離(F)	0.15mm以上	満たない場合、インクのダレ込みのリスク有り ※アスペクト比12以上は事前検討が必要
⑤熱硬化インクでの加工の場合	表面粗化処理は不可	処理有りの場合粗化面除去が必要

3)NSツール手配フローと、必要データおよび製品情報の支給について	
項目	記載事項
①新規製品情報通知書(別紙)	ワークサイズやインク種がツール準備に必要となります
②フィルム作製 (フィルム顧客支給の場合は4)へ)	穴埋め用データ(NCドリルデータ)を支給願います ※充填するTHやしないTH、ガイド穴などでの特別指示は、ツール番号表にてご連絡下さい ※同じツール番号で充填しないTHがある場合、充填するTHのみのデータをご準備下さい
③スクリーン版作製	上記支給フィルムまたはNS手配フィルムにて作成
④治具板作製	NCドリルデータを支給願います(②で支給いただいた場合は不要です)
⑤穴埋め用データ支給日(リードタイム)	加工開始予定日の前日朝までに支給願います。②-④の作成に1日必要

4)製版用フィルム支給について	
項目	記載事項
①フィルム膜面	支給して頂くデータと同様の面視で充填するTHのみ黒点・膜上にて出力願います
②フィルム点径	下記表5)に記載された基準値で出力願います
③フィルム寸法補正	X、Y 0%にて支給願います(寸法差が著しい場合は、リピート時別途相談になります)
④異径混在品	異径差0.20mm以上の場合、分割印刷が必要となるため別途お打合せが必要です

5)顧客支給の製版用フィルム点径設定基準 (単位:mm)				
THキリ径(A)	0.10 ≤ A < 0.15	0.15 ≤ A ≤ 0.35	0.35 < A ≤ 0.60	0.60 < A
フィルム点径(B)	事前確認要	A + 0.20	アスペクト比 8.0以下 : A + 0.30 アスペクト比 8.1以上 : A + 0.35	事前確認要

6)その他事項	
項目	記載事項
①仕様外加工製品	フラットプラグ加工仕様から外れる製品加工については、個別に調整させて頂きます。
②新規製品情報通知書	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
③NCデータ	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
④製版用支給フィルム	製造部 生産管理課宛 に発送をお願いします。